第一图书网, tushu007.com

<<SMT连接技术手册>>

图书基本信息

书名：<<SMT连接技术手册>>

13位ISBN编号：9787121041013

10位ISBN编号：7121041014

出版时间：2008-1

出版时间：电子工业

作者：中国电子科技集团电子电路柔性制造中心 编著

页数：327

字数：431

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

<<SMT连接技术手册>>

内容概要

本书在系统地介绍电子电路表面组装技术（SMT）中常用的各种连接方法的原理及应用要领，即电子电路电气互连技术简介及烙铁焊、再流焊、波峰焊、压焊、黏接、陶瓷与金属连接、印制板组件焊后的清洗和三防处理的基本原理、操作技巧的基础上，突出讲述了面向无铅组装的设计和印制板组件的无铅焊接技术。

本书既可作为电子产品结构工艺、电子材料、SMT等专业的大中专课程的教材或参考书，也可供电子产品研究、设计、制造单位相关工程技术人员和生产一线人员参考。

第一图书网, tushu007.com

<<SMT连接技术手册>>

书籍目录

第1章 概述? 1.1 电气互连的重要性 1.2 电气互连的分类? 1.3 电气互连的发展? 1.4 电气互连的核心——板级电路互连?第2章 烙铁焊接? 2.1 烙铁焊接方法的定义及其重要性? 2.2 焊点形成的基本原理? 2.3 印制板烙铁焊接五要素 2.4 烙铁焊接的操作技能 2.5 元器件引线的成形 2.6 元器件插装 2.7 印制板无铅烙铁焊接第3章 再流焊 3.1 再流焊原理 3.2 再流焊炉的选用 3.3 再流焊的缺陷及其解决方法 3.4 无铅再流焊 3.5 再流焊的某些发展趋势第4章 波峰焊 4.1 概述 4.2 波峰焊技术 4.3 波峰焊的主要缺陷及解决办法 4.4 无铅波峰焊? 4.5 元器件引线的成形?第5章 印制电路组件的清洗 5.1 印制电路组件清洗的重要性 5.2 印制电路组件的清洗机理 5.3 清洗剂与清洗方法? 5.4 影响清洗的因素 5.5 清洗质量标准及其评定 5.6 PCBA清洗总体方案设计 5.7 免清洗技术第6章 印制板组件的三防技术 6.1 三防技术的重要性? 6.2 三防技术的内容 6.3 环境因素对电子设备的影响 6.4 电子设备的三防第7章 金属粘接技术 7.1 金属粘接在微电子组装中的重要性 7.2 粘接机理 7.3 导电胶粘接技术第8章 压接第9章 陶瓷及其与金属的连接第10章 面向无铅组装的设计附录A 电子信息产品污染控制管理办法附录B WEEE和RoHS指令所涉及的电力电子产品种类附录C 日本工业标准JIS Z 3198：无铅焊料试验方法附录D 印制电路板组件装焊后的洁净度检测及分级附录E 印制电路板组件装焊后的清洗工艺方法参考文献

第一图书网, tushu007.com

<<SMT连接技术手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com